

岡本工作機械製作所 (6125) Q1 決算取材メモ アウトパフォーム (継続)

18/3 期は半導体関連活況で 75.7% 経常増予想も上振れ期待、来期も収益上伸で企業変革へ

株価 261 円 (8/10) 時価総額 123 億円 (8/10) 発行済株 47,179 千株 (8/10)
 PER (18/3DO 予 : 9.9X) PBR (1.23X) 配当 (18/3) 5.00 円 配当利回り : 1.92%

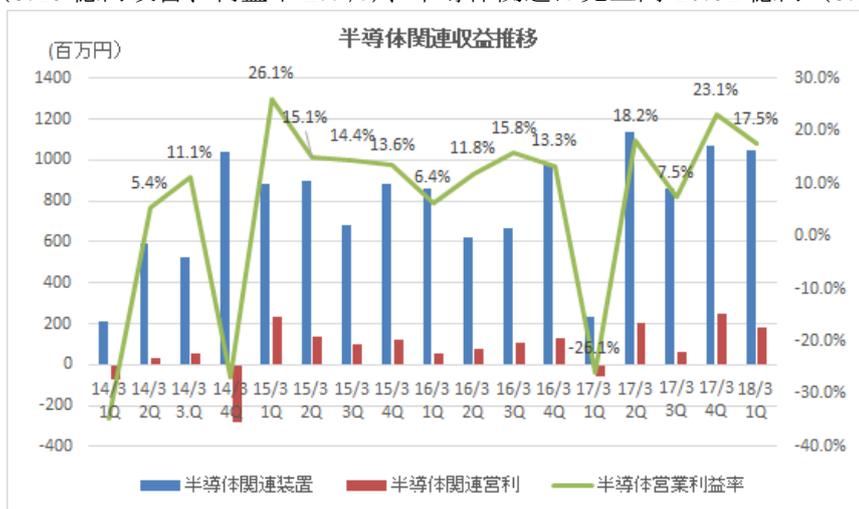
要約

- ・ 18/3 期 Q1 は 40% 増収、利益はすべて黒字転換、受注は半導体関連 4.4 倍増で全体 60% 増
- ・ 18/3 期は 17.9% 増収、40.4% 営業増、75.7% 経常増益も半導体関連装置活況で上振れへ
- ・ 19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円から上乘せも
- ・ 株価は併合後 18/3 期 DO 予想 EPS282 円に対して精密平均 PER26.7 倍の 7500 円目標

18/3 期 Q1 は 40% 増収、利益はすべて黒字転換、受注は半導体関連 4.4 倍増で全体 60% 増

8/9 に 18/3 期 Q1 決算が開示された。18/3 期 Q1 は売上高 56.75 億円 (40.9% 増)、営業利益 1.03 億円 (5.47 億円改善)、経常利益 0.68 億円 (6.09 億円改善)、税引利益 0.37 億円 (6.10 億円改善) と、すべて黒字転換となった。また受注額は 59.8% 増の 87.99 億円、受注残高は 50.1% 増の 97.76 億円と上伸した。

部門別では工作機械部門が売上高 46.23 億円 (25.2% 増)、受注高 60.54 億円 (24.2% 増)、営業利益 1.26 億円 (3.19 億円改善、利益率 2.7%)、半導体関連は売上高 10.51 億円 (3.15 倍)、受注高 27.45 億円 (5.4 倍)、営業利益 1.84 億円 (2.45 億円改善、営業利益率 17.5%) と伸長した。基本的に半導体設備投資の活況で半導体関連が伸長、また工作機械関連も汎用研削盤



はボトム確認程度も、半導体関連業界向けに超精密研削盤が伸長、工作機械が 18% 増の 26 億円、また歯車 (自動車向けやロボット向け) も 20% 増の 12 億円など増収率が高まった。

18/3 期は 17.9% 増収、40.4% 営業増、75.7% 経常増益も半導体関連装置活況で上振れへ

Q1 の好調はあるものの、利益水準がまだ低いとして、18/3 期会社予想の変更はなく、売

上高 280 億円 (17.9%増)、営業利益 16 億円 (40.4%増)、経常利益 13.5 億円 (75.7%増)、税引利益 11 億円 (90.5%増)、配当 5 円予想を据え置いた。会社側では期初の説明会で売上高の部門別予想として、平面研削盤他・半導体関連装置で 200 億円 (研削盤 150~160 億円、半導体関連装置 50~40 億円) その他鋳物、歯車で 80 億円とていたが、Q1 で受注が 87.99 億円、受注残が 97.76 億円水準あり、受注環境は半導体関連が中国向け、グローバルには 3D 積層化ニーズから活発な引き合いがあり、さらにほぼ独占状況にある SAW フィルタ向けなど、脆弱部材向けの需要も活発。また工作機械も汎用研削盤においてもものづくり補助金申請効果が表れはじめこちらも伸びが高まろう。さらにロボット向けをターゲットとして歯車新工場が下期本格稼働するなど、受注増と受注残消化が進む中で、会社予想を上回る収益が期待される。

19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円から上乘せも

現在、半導体においては微細化、3D 化などでウエハの平坦度要求、さらにはデバイスにおいては積層化で薄化ニーズが著しく、高付加価値のウエハーポリッシャー、ポリシングマシン、グラインディングマシンの活況が続こう。また同社は次世代パワー半導体用 SIC、GaN サファイア等の脆性材加工装置ではほぼ寡占化、19/3 期も活況が続くと判断でき、19/3 期は生産能力の上限に近い 65 億円程度の売上まで拡大しよう。工作機械関連でも、ロボット用歯車新工場がフル稼働し、19/3 期は大きく伸長が見込まれる。さらに研削盤においては超精密大型研削盤が大型 LCDTV 工場の新設ラッシュ、米国向けには航空機向け需要も拡大しつつある。なお、LCDTV 設備投資に関連し、同社しか対応できない次世代 LCD フォトマスク用ポリシングマシンなどの受注も期待される。また同社はウエハ研磨用ファイナルポリッシャーでは世界シェア 80~90% を握る。今週、サムコが設備増強を表明、先端ウエハの超平坦度要求が増し高付加価値の超高精度ファイナルポリッシャーへの置換実需に加え、来期は増設需要も取り込むことになろう。

上記の環境から、19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円を凌駕する収益拡大が見込める。



株価は併合後 18/3 期 DO 予想 EPS282 円に対して精密平均 PER26.7 倍の 7500 円目標

株価は 18/3 期会社予想 EPS24.9 円に対して 10.5 倍水準と依然割安感がある。すでに半導体製造装置関連銘柄との認識で、最近のウエハデバイスの活況なども考慮し、併合後 DO 予想 EPS282 円に対して精密平均 PER26.3 倍の 7500 円に目標株価とする。なお次世代デバイス向け製造装置が具体化すれば、エッチングや CMP 工程を大幅に削減して TSV ウエハ全自動薄化が可能となるだけに、次世代半導体製造装置関連銘柄として併合後 19/3 期 DO 予想 EPS451 円に対して PER50 倍の 22500 円まで変貌する可能性がある。

	岡本工作機械製作所(6125)				(million yen,yoy%,yen/share)				EPS	Div.
	SALES	yoy	OP	yoy	RP	yoy	NI	yoy		
15/3 期	26,149	28.5%	1,431	黒転	1,035	黒転	870	黒転	19.6	3.00
16/3 期	25,625	-2.0%	1,226	-14.3%	971	-6.2%	561	-35.5%	12.7	3.00
17/3 上期	10,909	-12.1%	366	-17.2%	135	-64.3%	63	-64.1%	1.4	0.00
17/3 下期	12,791	-3.2%	764	-2.6%	625	6.5%	507	32.0%	11.6	0.00
17/3 期会予(期初)	25,000	-2.4%	1,000	-18.4%	700	-27.9%	400	-28.7%	9.0	3.00
17/3 期	23,749	-7.3%	1,139	-7.1%	768	-20.9%	577	2.9%	13.0	4.00
18/3 期Q1	5,675	40.9%	103	黒転	68	黒転	37	黒転	0.85	0.00
18/3 期Q2 会予(8/9)	7,325	6.4%	397	-50.9%	282	-58.3%	213	-3.2%	4.80	2.00
18/3 上期会予	13,000	19.2%	500	36.6%	350	159.3%	250	296.8%	5.65	2.00
18/3 下期会予	15,000	17.3%	1,100	44.0%	1,000	60.0%	850	67.7%	192.1	30.00
18/3 期会予	28,000	17.9%	1,600	40.5%	1,350	75.8%	1,100	90.6%	248.6	50.00
19/3 期会社中計予想	32,000	14.3%	2,550	59.4%						
18/3 上期DO予	13,200	21.0%	550	50.3%	400	196.3%	300	376.2%	6.8	2.00
18/3 下期DO予	15,300	19.6%	1,250	63.6%	1,150	84.0%	950	87.4%	214.7	30.00
18/3 期DO予	28,500	20.0%	1,800	58.0%	1,550	101.8%	1,250	116.6%	282.5	50.00
19/3 期DO予	34,500	21.1%	3,000	66.7%	2,850	83.9%	2,000	60.0%	451.2	70.00
	18/3 期株式併合あり 10株を1株									

通期	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3 会予	18/3DO	19/3DO
売上高	20,344	26,149	25,625	23,749	28,000	28,500	34,500
売上原価	15,849	18,690	18,168	16,664	19,500	19,800	23,800
売上総利益	4,495	7,459	7,457	7,085	8,500	8,800	10,700
販管費	5,271	6,027	6,230	5,945	6,900	6,900	7,700
営業利益	-776	1,431	1,226	1,139	1,600	1,800	3,000
経常利益	-925	1,035	971	768	1,350	1,550	2,850
税引利益	-1,562	870	561	577	1,100	1,250	2,000
工作機械	17,978	22,807	22,488	20,447	20,000~24,000	23,500	27,000
(鋳物他)	2,307	3,732	2,590	2,279	2,500	2,500	3,000
(歯車加工)	3,704	4,760	4,247	4,292	5,000	5,000	7,000
(平面研削盤他)	11,967	14,381	15,652	13,877	15,500~16,500	16,000	17,000
半導体製造装置	2,366	3,339	3,136	3,301	3,000~4,000	5,000	7,500
工作機械営業	97	1,571	1,653	1,465		1,800	2,100
半導体製造装置営業	-262	584	365	457		1,000	1,700
調整利益	-611	-724	-793	-783		-800	-800
受注合計	21,750	26,840	24,410	25,367	30,000	32,000	35,500
工作機械受注	18,611	23,944	21,126	20,914		24,500	26,500
半導体製造装置受注	3,139	2,895	3,283	4,453		7,500	9,000
受注残合計	5,557	6,249	5,034	6,652	8,652	11,652	13,652
工作機械受注残	4,567	5,705	4,343	4,809		5,809	6,309
半導体製造装置受注残	989	543	690	1,842		5,843	7,343

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS,LTD.

2017/8/9

